

國立高雄大學 x 台積電

半導體學程說明會

掌握 半導體 知識
成為 定義未來 科技的領導者

台積電 台灣人力資源營運處/ 陳昕哲(Sam)
2025-09-09



Unleash Innovation

為自己贏得 3 份禮物

Serial number: 202509100948-17181813



微學程修畢證書
(3門科目)

● ● ●
(說自己的故事)

半導體微學程 (最低須修畢 3 門科目)

修畢門檻：

1. 修畢所就讀理工科系大學部所有系訂必修科目(憑成績單)
2. + 修畢半導體學程中的「半導體製程」科目
3. + 修畢半導體學程中，任兩門「必修」或「核心選修」科目

透過學程系統申請通過

台積即授予「半導體微學程修畢證書」



微學程修畢證書
(3門科目)

Serial number: 202509100948-17181813

舉例：A選擇報名 半導體學程(最低須修畢 **11** 門科目)

必修(10選3)	核心選修(23選5)(可以用必修抵)	專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)
1 電子學一	1 電子學二	1 近代物理
2 半導體元件物理	2 微分方程/工程數學一	2 量子物理/量子力學
3 半導體製程	3 線性代數/工程數學二	3 半導體元件設計與模擬
4 電路學	4 固態物理	4 半導體元件量測
5 材料分析與檢測	5 電磁學	5 應用光電子學
6 分析化學	6 積體電路設計	6 進階積體電路設計
7 流體力學/輸送現象一	7 電子薄膜科技	7 同調光及電子繞射顯微術
8 半導體製程設備與技術	8 電漿工程與應用	8 物理光學
9 機器人與自動化應用	9 材料科學	9 材料物理性質
10 實驗設計與統計應用	10 熱力學	10 熱傳學/輸送現象二
	11 儀器分析	11 無機化學
	13 表面物理/表面化學	15 真空技術
	14 材料表面工程	16 電化學原理
	15 物理化學	17 可靠度工程分析
	16 有機化學	18 材料物理性質
	17 材料化學	19 應力分析
	18 電機機械	20 智慧製造技術
	19 機電整合與自動化應用	21 量測原理
	20 感測技術基礎科學	22 機器學習/深度學習
	21 化學工程	23 半導體奈米微影
	22 材料力學	24 電子封裝技術
	23 程式語言	25 積體電路封裝測試

於學程系統提出(微學程)修畢證書申請，檢具

1. 成績單 (完成科目以螢光筆註記)
2. 學士學位證書掃描檔 (用以佐證完成系訂必修)

法
:



微學程修畢證書
(3門科目)

● ● ●
(說自己的故事)



台積新人訓練中心
結訓證書

● ● ●
(台積主管很買單)
(必須報名半導體學程)

到台積新人訓練中心(NTC) 報名學程是 必要條件

再過幾個月我就可以來了



老師, 我力氣夠可以自己撕



哈哈, 樓下的貼成這樣



原來長這樣喔



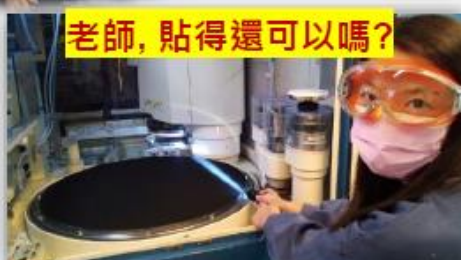
埃~怎麼會貼成這樣啊



YA~開心, 沒有Bubble耶



老師, 貼得還可以嗎?



我們一樣可以做到



Serial number: 202509100948-17181813

台積業師講授專屬課程

對象	報名 半導體學程 學生	
代碼	無課程代碼，由台積邀請學程學生自由參加	
開課單位	台積新人訓練中心 (TBD)	
課程名稱	半導體機台基礎 (選修)	半導體設備元件基礎 (選修)
課程目標	1. 對機台設計原理、操作與預防保養有基礎概念 2. 初步了解半導體設備實務工作內涵 3. 結合學校所學與產業實務	1. 對設備元件原理與作用有基礎認識 2. 初步了解半導體設備實務工作內涵 3. 結合學校所學與產業實務
實施方式	4個週六/ 梯 (寒/暑假：連續4天/ 梯) 至台積新人訓練中心接受訓練	



微學程修畢證書
(3門科目)



(說自己的故事)



台積新人訓練中心
結訓證書



(台積主管很買單)
(必須報名半導體學程)



台積半導體學程
修畢證書



(產業敲門磚)
(11門科目)

修畢 半導體學程，您將...

獲頒修畢證書

修滿學程規定科目者，經審查無誤後，由台積授予「**學程修畢證明書**」。

獲學程獎勵金

符合指定條件並獲錄取者，台積將提供**新台幣 15 萬元**學程獎勵金。
(到職首個撥薪日發放)

指定條件：

1. 學程科目修業平均成績達 80 分(含)以上
2. **碩一(含)以前**報名學程
3. 畢業後直接加入台積
4. 獲台積聘書(含預聘)前已上傳修畢證書至台積人才資料庫



澄清您的疑惑

1. 需要額外繳學分費嗎？ **不用**
2. 沒修完會有什麼影響嗎？ **不會** (虛擬學程)
3. 要怎麼修課？ **透過學校選課系統選課**
4. 碩士班不是唸高雄大學，修業紀錄可以帶著跑嗎？ **可抵修**



大學部修業紀錄皆可提出抵修 @台積學程合作學校

學程類別	清大	成大	陽明 交大	臺灣 臺大	臺灣 科大	臺北 科大	中山	中央	中興	中正	逢甲	元智	中原	臺灣 師大	雲林 科大	屏東 科大	高雄 科大	高雄 大學	高雄 師大
半導體				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
元件整合	●	●	●				●												
製程模組	●		●				●												
設備工程		●	●				●												
電路設計	●	●	●	●	●			●	●										
智慧製造	●	●			●	●		●			●	●	●		●	●			

*依合作開辦順序排列

+ 立即掃描QR Code報名修讀學程

Scan me!



<https://careers.tsmc.com/education>

修讀學程好處：

- ▶ 能參與學程學生專屬活動
- ▶ 修畢學程且成績達標，錄取台積時可享有學程獎勵金

學程承辦窗口

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

0978-211-692

Morgen Liao (廖晨瑄)

chliaoam@tsmc.com

0978-210-393

學程系統窗口

Jenny Cheng (鄭惠甄)

hjcheng@tsmc.com

0988-937-550

報名修讀毋須有壓力！報名後若未順利達成修畢門檻，僅無法獲得學程修畢證書，完全不影響在校任何成績或表現喔！



來信諮詢學程相關事宜

請於信末留下 **手機號碼** 方便聯繫

(雙向溝通 容易釐清問題所在)

用私人電子郵件 註冊帳號 報名學程



報名
半導體學程



報名
學生專屬活動



應徵
台積電職缺
(搜尋職缺)

讓學程修業資訊
與您的履歷勾稽在一起

升級履歷好處

暑期實習 優先邀請學程學生面談(大三以上)



Unleash Innovation



台積電
招募管理系統

【操作小幫手】



027710, 陳昕哲

基本資料設定 履歷管理 履歷挑選 平日面談 專場面談 技術員招募 查歷查核 任用/薪資文件 聘書文件 預約面談

首頁 / 履歷資訊

繁體中文 ▾

National Yang MingCh

希望工作地點 台灣(

半導體學程-已報名

半導體學程-已報名



挑選



推薦



編輯



輸入測驗成績



面試評估



整體任用決定



離職回任



法遵查核



資歷查核



任用答辯書



任用建議書



標籤



筆記



下載RP履歷表

個人資料 專業 工作經驗 學歷 招募資訊 附檔 招募歷程

個人資料



基本資訊

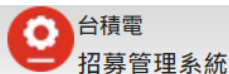
Serial number: 202509100948-17181813

升級履歷好處

修畢且成績達標 給予學程獎勵金



Unleash Innovation



【操作小幫手】

027710, 陳昕哲

基本資料設定 履歷管理 履歷挑選 平日面談 專場面談 技術員招募 資歷查核 任用/薪資文件 聘書文件 預約面談

首頁 / 履歷資訊

繁體中文

National Taiwan University (NTU) 國立

希望工作地點 台灣(新竹、龍潭、竹

半導體學程-已修畢且享學程獎勵金

半導體學程-已修畢且享學程獎勵金

✓ 挑選

📷 推薦

✎ 編輯

📝 輸入測驗成績

📝 面試評估

👤 整體任用決定

♻️ 離職回任

📋 法遵查核

👤 資歷查核

📝 任用答辯書

📝 任用建議書

📌 標籤

📝 筆記

📄 下載RP履歷表

個人資料 專業 工作經驗 學歷 招募資訊 附檔 招募歷程

個人資料

☰

基本資訊

Serial number: 202509100948-17181813



國立高雄大學 x 台積電 攜手合作半導體學程

半導體學程

(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 半導體製程設備與技術
- 9 機器人與自動化應用
- 10 實驗設計與統計應用

核心選修(23選5)(可以用必修抵)

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 電子學二 | 13 表面物理/表面化學 |
| 2 微分方程/工程數學一 | 14 材料表面工程 |
| 3 線性代數/工程數學二 | 15 物理化學 |
| 4 固態物理 | 16 有機化學 |
| 5 電磁學 | 17 材料化學 |
| 6 積體電路設計 | 18 電機機械 |
| 7 電子薄膜科技 | 19 機電整合與自動化應用 |
| 8 電漿工程與應用 | 20 感測技術基礎科學 |
| 9 材料科學 | 21 化學工程 |
| 10 熱力學 | 22 材料力學 |
| 11 儀器分析 | 23 程式語言 |
| 12 物理冶金 | |

專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1 近代物理 | 15 真空技術 |
| 2 量子物理/量子力學 | 16 電化學原理 |
| 3 半導體元件設計與模擬 | 17 可靠度工程分析 |
| 4 半導體元件量測 | 18 材料物理性質 |
| 5 應用光電子學 | 19 應力分析 |
| 6 進階積體電路設計 | 20 智慧製造技術 |
| 7 同調光及電子繞射顯微術 | 21 量測原理 |
| 8 物理光學 | 22 機器學習/深度學習 |
| 9 材料物理性質 | 23 半導體奈米微影 |
| 10 熱傳學/輸送現象二 | 24 電子封裝技術 |
| 11 無機化學 | 25 積體電路封裝測試 |
| 12 電子材料 | 26 數值方法 |
| 13 高分子科學 | 27 偏微分方程數值方法 |
| 14 化學動力學/化工動力學 | 28 半導體實務@tsmc |

台積新人訓練中心
半導體實作課程

(電機)半導體學程

(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 半導體製程設備與技術
- 9 機器人與自動化應用
- 10 實驗設計與統計應用

核心選修(23選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 電子薄膜科技
- 8 電漿工程與應用
- 9 材料科學
- 10 熱力學
- 11 儀器分析
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學
- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 電機機械
- 19 機電整合與自動化應用
- 20 感測技術基礎科學
- 21 化學工程
- 22 材料力學
- 23 程式語言

專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 進階積體電路設計
- 7 同調光及電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料物理性質
- 10 熱傳學/輸送現象二
- 11 無機化學
- 12 電子材料
- 13 高分子科學
- 14 化學動力學/化工動力學
- 15 真空技術
- 16 電化學原理
- 17 可靠度工程分析
- 18 材料物理性質
- 19 應力分析
- 20 智慧製造技術
- 21 量測原理
- 22 機器學習/深度學習
- 23 半導體奈米微影
- 24 電子封裝技術
- 25 積體電路封裝測試
- 26 數值方法
- 27 偏微分方程數值方法
- 28 半導體實務@tsmc

電機系大學部科目

電機系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202509100948-17181813

(化材)半導體學程(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 半導體製程設備與技術
- 9 機器人與自動化應用
- 10 實驗設計與統計應用

核心選修(23選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 電子薄膜科技
- 8 電漿工程與應用
- 9 材料科學
- 10 熱力學
- 11 儀器分析
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學
- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 電機機械
- 19 機電整合與自動化應用
- 20 感測技術基礎科學
- 21 化學工程
- 22 材料力學
- 23 程式語言

專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 進階積體電路設計
- 7 同調光及電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料物理性質
- 10 熱傳學/輸送現象二
- 11 無機化學
- 12 電子材料
- 13 高分子科學
- 14 化學動力學/化工動力學
- 15 真空技術
- 16 電化學原理
- 17 可靠度工程分析
- 18 材料物理性質
- 19 應力分析
- 20 智慧製造技術
- 21 量測原理
- 22 機器學習/深度學習
- 23 半導體奈米微影
- 24 電子封裝技術
- 25 積體電路封裝測試
- 26 數值方法
- 27 偏微分方程數值方法
- 28 半導體實務@tsmc

化材系大學部科目

化材系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202509100948-17181813

(土木)半導體學程

(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 半導體製程設備與技術
- 9 機器人與自動化應用
- 10 實驗設計與統計應用

核心選修(23選5)(可以用必修抵)

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 電子學二 | 13 表面物理/表面化學 |
| 2 微分方程/工程數學一 | 14 材料表面工程 |
| 3 線性代數/工程數學二 | 15 物理化學 |
| 4 固態物理 | 16 有機化學 |
| 5 電磁學 | 17 材料化學 |
| 6 積體電路設計 | 18 電機機械 |
| 7 電子薄膜科技 | 19 機電整合與自動化應用 |
| 8 電漿工程與應用 | 20 感測技術基礎科學 |
| 9 材料科學 | 21 化學工程 |
| 10 熱力學 | 22 材料力學 |
| 11 儀器分析 | 23 程式語言 |
| 12 物理冶金 | |

專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 近代物理 | 15 真空技術 |
| 2 量子物理/量子力學 | 16 電化學原理 |
| 3 半導體元件設計與模擬 | 17 可靠度工程分析 |
| 4 半導體元件量測 | 18 材料物理性質 |
| 5 應用光電子學 | 19 應力分析 |
| 6 進階積體電路設計 | 20 智慧製造技術 |
| 7 同調光及電子繞射顯微術 | 21 量測原理 |
| 8 物理光學 | 22 機器學習/深度學習 |
| 9 材料物理性質 | 23 半導體奈米微影 |
| 10 熱傳學/輸送現象二 | 24 電子封裝技術 |
| 11 無機化學 | 25 積體電路封裝測試 |
| 12 電子材料 | 26 數值方法 |
| 13 高分子科學 | 27 偏微分方程數值方法 |
| 14 化學動力學/化工動力學 | 28 半導體實務@tsmc |

土木系大學部科目

土木系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202509100948-17181813

(應物)半導體學程

(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 半導體製程設備與技術
- 9 機器人與自動化應用
- 10 實驗設計與統計應用

核心選修(23選5)(可以用必修抵)

- 1 電子學二
- 2 微分方程/工程數學一
- 3 線性代數/工程數學二
- 4 固態物理
- 5 電磁學
- 6 積體電路設計
- 7 電子薄膜科技
- 8 電漿工程與應用
- 9 材料科學
- 10 熱力學
- 11 儀器分析
- 12 物理冶金
- 13 表面物理/表面化學
- 14 材料表面工程
- 15 物理化學
- 16 有機化學
- 17 材料化學
- 18 電機機械
- 19 機電整合與自動化應用
- 20 感測技術基礎科學
- 21 化學工程
- 22 材料力學
- 23 程式語言

專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

- 1 近代物理
- 2 量子物理/量子力學
- 3 半導體元件設計與模擬
- 4 半導體元件量測
- 5 應用光電子學
- 6 進階積體電路設計
- 7 同調光及電子繞射顯微術
- 8 物理光學
- 9 材料物理性質
- 10 熱傳學/輸送現象二
- 11 無機化學
- 12 電子材料
- 13 高分子科學
- 14 化學動力學/化工動力學
- 15 真空技術
- 16 電化學原理
- 17 可靠度工程分析
- 18 材料物理性質
- 19 應力分析
- 20 智慧製造技術
- 21 量測原理
- 22 機器學習/深度學習
- 23 半導體奈米微影
- 24 電子封裝技術
- 25 積體電路封裝測試
- 26 數值方法
- 27 偏微分方程數值方法
- 28 半導體實務@tsmc

應物系大學部科目

應物系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202509100948-17181813

(應化)半導體學程

(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)

- 1 電子學一
- 2 半導體元件物理
- 3 半導體製程
- 4 電路學
- 5 材料分析與檢測
- 6 分析化學
- 7 流體力學/輸送現象一
- 8 半導體製程設備與技術
- 9 機器人與自動化應用
- 10 實驗設計與統計應用

核心選修(23選5)(可以用必修抵)

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 電子學二 | 13 表面物理/表面化學 |
| 2 微分方程/工程數學一 | 14 材料表面工程 |
| 3 線性代數/工程數學二 | 15 物理化學 |
| 4 固態物理 | 16 有機化學 |
| 5 電磁學 | 17 材料化學 |
| 6 積體電路設計 | 18 電機機械 |
| 7 電子薄膜科技 | 19 機電整合與自動化應用 |
| 8 電漿工程與應用 | 20 感測技術基礎科學 |
| 9 材料科學 | 21 化學工程 |
| 10 熱力學 | 22 材料力學 |
| 11 儀器分析 | 23 程式語言 |
| 12 物理冶金 | |

專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 近代物理 | 15 真空技術 |
| 2 量子物理/量子力學 | 16 電化學原理 |
| 3 半導體元件設計與模擬 | 17 可靠度工程分析 |
| 4 半導體元件量測 | 18 材料物理性質 |
| 5 應用光電子學 | 19 應力分析 |
| 6 進階積體電路設計 | 20 智慧製造技術 |
| 7 同調光及電子繞射顯微術 | 21 量測原理 |
| 8 物理光學 | 22 機器學習/深度學習 |
| 9 材料物理性質 | 23 半導體奈米微影 |
| 10 熱傳學/輸送現象二 | 24 電子封裝技術 |
| 11 無機化學 | 25 積體電路封裝測試 |
| 12 電子材料 | 26 數值方法 |
| 13 高分子科學 | 27 偏微分方程數值方法 |
| 14 化學動力學/化工動力學 | 28 半導體實務@tsmc |

應化系大學部科目

應化系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202509100948-17181813

(應數)半導體學程

(最低須修畢 **11** 門科目； **8** 門必/核心選修及 **3** 門專業選修)

必修(10選3)	核心選修(23選5)(可以用必修抵)	專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)
1 電子學一	1 電子學二	1 近代物理
2 半導體元件物理	2 微分方程/工程數學一	2 量子物理/量子力學
3 半導體製程	3 線性代數/工程數學二	3 半導體元件設計與模擬
4 電路學	4 固態物理	4 半導體元件量測
5 材料分析與檢測	5 電磁學	5 應用光電子學
6 分析化學	6 積體電路設計	6 進階積體電路設計
7 流體力學/輸送現象一	7 電子薄膜科技	7 同調光及電子繞射顯微術
8 半導體製程設備與技術	8 電漿工程與應用	8 物理光學
9 機器人與自動化應用	9 材料科學	9 材料物理性質
10 實驗設計與統計應用	10 熱力學	10 熱傳學/輸送現象二
	11 儀器分析	11 無機化學
	12 物理冶金	12 電子材料
		13 高分子科學
		14 化學動力學/化工動力學
	13 表面物理/表面化學	15 真空技術
	14 材料表面工程	16 電化學原理
	15 物理化學	17 可靠度工程分析
	16 有機化學	18 材料物理性質
	17 材料化學	19 應力分析
	18 電機機械	20 智慧製造技術
	19 機電整合與自動化應用	21 量測原理
	20 感測技術基礎科學	22 機器學習/深度學習
	21 化學工程	23 半導體奈米微影
	22 材料力學	24 電子封裝技術
	23 程式語言	25 積體電路封裝測試
		26 數值方法
		27 偏微分方程數值方法
		28 半導體實務@tsmc

應數系大學部科目

應數系研究所科目

建議多修科目

Serial number: 202509100948-17181813

報名後請下載 學程科目對照表 獲得學習指引



Education

半導體學程

搜尋職缺

台積公司職涯

關於台積公司

中文



登入/

學校 國立臺灣科技大學

類別 製程/模組

最低修畢科目數 11

修畢門檻 2門必修 + 6門必選修 + 3門選修

學程負責人

學程系統相關問題: 鄭惠甄 HJCHENG@TSMC.COM

學程其他問題: 陳昕哲 HCCHERN@TSMC.COM、

廖晨瑄 CHLIAOAM@TSMC.COM

申請

分享



學程說明

1. 修畢半導體學程將享有以下權益:

- 獲頒修畢證書: 修滿學程規定科目與學分者, 經主持系所審查無誤後, 由台積授予「學程修畢證明書」。
- 獲得面試保證: 獲頒「學程修畢證明書」者, 申請台積職缺將保證獲得面試機會。
- 獲學程獎勵金: 台積將提供獎勵金給學程修業平均成績達80分(含)以上、碩一(含)以前需申請報名學程、於獲台積正職職缺聘書(含預聘)前已上傳學程修畢證書至台積履歷系統、(取得最高學歷)畢業後直接加入台積者。

2. 半導體學程科目之必修/必選修/選修、課程抵修採認規定, 不代表在校課程修業規範。

3. 報名後未修畢本學程者, 僅無法獲得本學程之修畢證書, 不影響學生在校任何成績或表現。

4. 報名半導體學程者, 將有機會受邀參加學程專屬系列活動。

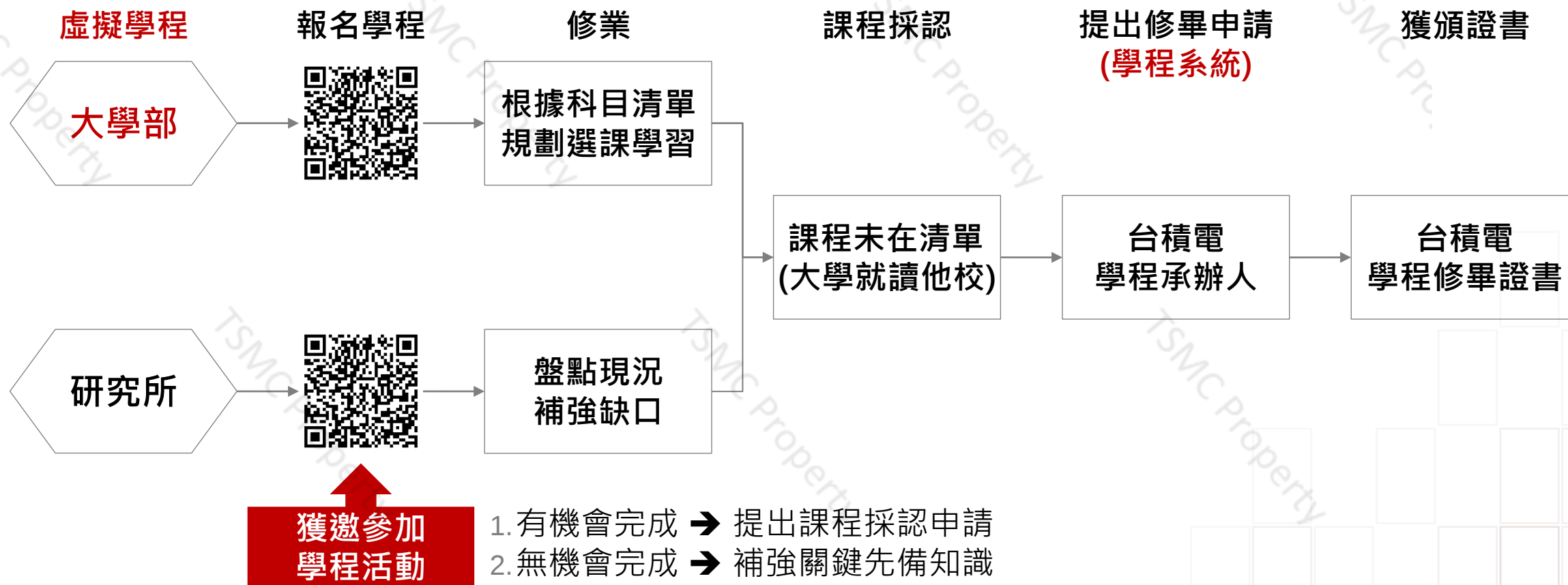
5. 「取得學程修畢證書, 保證面試」適用範圍僅限台積公司台灣廠區(TSMC Taiwan), 不適用海外子公司。

6. 台灣積體電路製造股份有限公司針對以上方案保留修改及解釋之權利。

 科目對照表

Serial number: 202509100948-17181813

研修策略建議



(虛擬)學程 6 好處

1

台積電業師講授專屬課程(特定學程)

2

有機會參與NTC課程(特定學程)

3

參訪台積電晶圓廠/設備商

4

受邀參加學程專屬系列活動

1

獲頒修畢證書

2

獲學程獎勵金

問題與交流

<https://careers.tsmc.com/education>



掌握 半導體 知識
成為 定義未來 科技的領導者

Q1 如何報名半導體學程？



<https://careers.tsmc.com/education>

至學程網頁登錄

(選擇與高雄大學合作學程報名)

台積將不定期通知學程相關系列活動。

Q2 學程科目採認的課程可否回溯？

可以 ^^

凡符合申請資格者(高雄大學各系/所全時在學學生)，

報名後即可追溯其大學迄今所修習過之學程科目，

惟提交學程修畢證書申請時，參照之科目對照表以所在學校半導體學程為準。

Q3 大學非就讀高雄大學，所修對應學程科目的課程會採認嗎？

有機會！但須提出**課程採認申請**

(**非透過學程系統**，請下載科目對照表 - 課程延續採認申請表)

半導體學程合作學校：

1. 該校與**高雄大學**學程科目對照表皆有**列入**者，直接採認(即抵修)。
2. 該校學程科目對照表**未列入**，採實質審查，需於提出課程採認申請時，檢附所欲採認課程(**抵修與被抵修**)之課程目標、課程大綱供檢視，內容相符程度逾**70%**者，即予以採認。

非半導體學程合作學校：**成績及格科目皆可提出採認申請**

(原則同上述第2點)

Q4 與台積攜手合作半導體學程的學校有哪些？

學程類別	清大	成大	陽明 交大	陽明 臺大	臺灣 科大	臺北 科大	中山	中央	中興	中正	逢甲	元智	中原	臺灣 師大	雲林 科大	屏東 科大	高雄 科大	高雄 大學	高雄 師大
半導體				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
元件整合	●	●	●				●												
製程模組	●		●				●												
設備工程		●	●				●												
電路設計	●	●	●	●	●			●	●										
智慧製造	●	●			●	●		●			●	●	●		●	●			

*依合作開辦順序排列

**Q5 本校其他系所課程未被列入科目對照表中，
但課程內容一樣，課程名稱也雷同，可否採認？**

有機會！但須提出課程採認申請(附件：台積電半導體學程_課程採認申請表)

採實質審查，需於提出課程採認申請時，檢附所欲採認課程之課程目標、課程大綱供檢視，內容相符程度逾70%者，即予以採認。

(原則上由主持系所審核後決議是否納入)

Q6 半導體學程修畢證書申請資格及方式？

申請資格：

申請時需仍為**高雄大學**各系/所之全時在學學生(即畢業前提出申請)。

申請方式：

提出**半導體學程修畢證書申請**(於學程系統提出申請)

同時上傳

- **成績單**(對應修畢的課程以顏色作註記)
- **學程採認(抵免)申請結果**(如果曾經申請抵免)

提交半導體學程修畢證書申請前注意事項

- 僅受理審查**已報名半導體學程者**提出之申請
- 學程獎勵金僅適用於滿足以下四個條件者：
 1. **碩一(含)前，已報名學程**
 2. **修業平均成績達80分(含)以上**
 3. **(取得最高學歷)畢業後直接加入台積者**
 4. **獲台積正職職缺聘書(含預聘/研發替代役)前，完成認證申請，並上傳學程修畢證書至台積履歷系統**

Q7 總修習課程數多於修畢門檻，會有實質差異嗎？

不會 ☹

建議可以從修畢學程科目中，挑選成績最好的採認課程來申請。

(相同學程科目僅會採認1門課程)

半導體關鍵學能 (應完成必修1門+選修至少4門)									
# 學程科目名稱	學程訂定 必/選修	採認課程名稱	採認課程代碼	學分數	修畢課程 (打V)	分數 (百分制)	開課系/所	課程程度 (下拉選單)	開課學期 (下拉選單)
1 半導體元件物理	必	固態電子元件	3433	3			電機工程學系	大學部	下學期
		元件物理	6840	3			電機工程學系	研究所	上學期
		半導體元件物理	4208	3			材料科學與工程學系	大學部	上學期
		半導體物理與元件(-)	6615	3			物理學系	研究所	上學期
2 工程數學	選	工程數學(二)	2325/ 2326	3			電機工程學系	大學部	上學期
		工程數學(二)	2406	3			材料科學與工程學系	大學部	下學期
		工程數學(二)	2402	3			化學工程學系	大學部	下學期
		工程數學(二)	2327/ 2328	3			機械工程學系	大學部	下學期
		工程數學(二)	2208	3			生物產業機電工程學系	大學部	下學期
		物理數學(二)	2339	3			物理學系	大學部	下學期
		化學數學	2248	3			化學系	大學部	上學期
3 固態物理導論	選	固態物理導論	4299	3			電機工程學系	大學部	上學期
		固態物理導論	4118	3			材料科學與工程學系	大學部	下學期
		固態物理	6772	3			物理學系	研究所	下學期
4 近代物理	選	近代物理	2280	3			物理學系	大學部	上學期

Serial number: 202509100948-17181813